

Title (en)

Method for constructing a die, and embossing apparatus for carrying out the method

Title (de)

Verfahren zum Ausbilden einer Matrizenhohlform und Prägevorrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Title (fr)

Procédé de fabrication d'une matrice et dispositif de gaufrage pour la mise en oeuvre dudit procédé

Publication

EP 0924058 A1 19990623 (DE)

Application

EP 98122724 A 19981128

Priority

DE 19756094 A 19971217

Abstract (en)

The counter tool (45) and/or stamping die (33) are heated. The matrix comprises an ultra high molecular weight low pressure polyethylene, with a very high degree of polymerization. Plastics die formation takes place in the embossing machine, heating at same time. An Independent claim is included for the corresponding embossing equipment.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ausbilden einer Matrizenhohlform im Gegenwerkzeug eines Prägestempels (33) innerhalb einer Prägevorrichtung sowie eine Prägevorrichtung, die eine derart gefertigte Matrizenhohlform aufweist. Der Kern der Erfindung besteht darin, ein Gegenwerkzeug (45) aus einem zähelastischen bis zähharten Material, vorzugsweise thermoplastischem Kunststoff, einzusetzen und zum Ausbilden der Matrizenhohlform das Gegenwerkzeug (45) zu erwärmen. <IMAGE>

IPC 1-7

B31F 1/07

IPC 8 full level

B29C 33/40 (2006.01); **B29C 59/02** (2006.01); **B30B 15/02** (2006.01); **B31F 1/07** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B31F 1/07 (2013.01 - EP US); **B31F 2201/0717** (2013.01 - EP US); **B31F 2201/0728** (2013.01 - EP US); **B31F 2201/0782** (2013.01 - EP US); **B31F 2201/0784** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [XA] GB 1570821 A 19800709 - HALLMARK CARDS
- [A] GB 1259885 A 19720112 - ISOVOLTA [AT]
- [A] DE 4345128 A1 19950706 - DETROIT HOLDING LTD [IE]
- [A] US 5505125 A 19960409 - KAPOLNEK PAUL G [US]

Cited by

EP2711666A1; CN104755877A; WO2007028557A1; US10083253B2; DE102004029036B4; WO2014045176A3

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

EP 0924058 A1 19990623; **EP 0924058 B1 20040414**; CA 2254366 A1 19990617; DE 19756094 A1 19990624; DE 59811192 D1 20040519; JP H11235771 A 19990831; US 6105492 A 20000822

DOCDB simple family (application)

EP 98122724 A 19981128; CA 2254366 A 19981210; DE 19756094 A 19971217; DE 59811192 T 19981128; JP 35468698 A 19981214; US 17938598 A 19981027